

[illegible]



深圳市韩下电子有限公司

Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd

Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX 2.0mm-12P ZZ-MS

#### 贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	



## 1、SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验。

## 2、USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+85℃

环境温度：-25℃~+85℃

2.2 Applicable PC board thickness:1.2~1.6mm

适用 PC 板厚度：1.2~1.6 mm

## 3、Appearance and Dimension: (外观及尺寸)

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,  
Contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

## 4、Material:

材 料 （以图纸为准）

P/N 零件名称	Type 类 型	Material 材 料	Finish 表面处理	Expiain 说 明
Terminal 端子	Contact 插 簧	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	RoHS Comp liant
Housing 孔 座	Plastic 塑 壳	Nylon66 UL94V-0	Color:White 颜色：白色	
OpeningWafer 开口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	
Lips Wafer 闭口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Gold Plating:3~4 μ " m 镀金：3~4 μ " m	
	Plastic 塑 壳	PBT UL94V-0	Color: White 颜色：白色	
Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Solder tabs 焊护耳	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	

**5、Electrical Performance:**

电气性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
5.1	Voltage Rated 额定电压	250V AC DC
5.2	Current Rated 额定电流	2A AC DC
5.3	Contact Resistance 接触电阻	$\leq 20\text{ m}\Omega$
5.4	Insulation Resistance 绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$
5.5	Dielectric Strength 耐压	$\geq 800\text{V AC/minute}$

**6、Mechanical Performance:**

机械性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
6.1	Male contact Retention force PIN 针固定力	$\geq 10\text{N}$ per pin
6.2	Female contact Retention force 端子固定力	$\geq 10\text{N}$ per pin
6.3	Plug-in force 插入力	$\leq 3\text{N}$ per pin
6.4	Plug-out force 拔出力	$\geq 0.5\text{N}$ per pin

**7、Endurance Characteristics:**

环境性能

NO. 序号	Item 项目	Requirement 技术要求
7.1	Soldering test 可焊性	Time: $2.5 \pm 0.5\text{S}$ 时间: $2.5 \pm 0.5\text{S}$ Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ Area of Soldering: $\geq 95\%$ 焊锡面积: $\geq 95\%$
7.2	Resistance to soldering Heat 耐焊接热	Time: $5 \pm 1\text{S}$ 时间: $5 \pm 1\text{S}$ Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ Appearance: NO Damage 外观: 无损坏

7.3	Heat test 耐热性	<p>Time:96h 时间: 96 小时</p> <p>Temperature:+85±3℃ 温度: +85±3℃</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p>
7.4	Cold test 耐冷性	<p>Time:48h 时间: 48 小时</p> <p>Temperature:-25±3℃ 温度: -25±3℃</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p>
7.5	Temperature Cycling 温度循环	<p>Low temperature:-25±3℃ 低温: -25±3℃</p> <p>High temperature:85±3℃ 高温: 85±3℃</p> <p>For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min.</p> <p>5 次循环后, 放置在正常环境中 30 分钟, 进行测试</p> <p>Appearance: NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20mΩ</p>
7.6	Invariab lenes humidity 恒定湿热	<p>Temperature:60±2℃ 温度: 60±2℃</p> <p>Relative humidity:90%-96% RH</p> <p>相对湿度: 90%-96% RH</p> <p>Tim:96h 时间: 96 小时</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ</p> <p>Insulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻: ≥100 MΩ</p>
7.7	Salt Spray 盐雾试验	<p>Salt concentration: 5±1% 浓度: 5±1%</p> <p>Temperature:35±2℃ 温度: 35±2℃</p> <p>Tim:16±2h 时间: 16±2 小时</p> <p>After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured.</p> <p>把试验样品从试验箱顶悬挂下来, 采用浓度 (5±1) %的 氯化钠溶液, 连续雾化 16 小时, 试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时, 外观无损伤</p> <p>Appearance:NO Damage 外观: 无损坏</p> <p>Contact resistance: ≤20 mΩ</p> <p>接触电阻: ≤20 mΩ</p>